



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4903

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

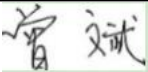


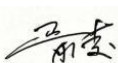
申请编号: V2023CQC001041-1118341

产品名称: SOP16 宽体数字隔离器

型 号: 见样品描述及说明

检测机构: 中国质量认证中心华南实验室



<p>申请编号: V2023CQC001041-1118341 (任务编号) 样品名称: SOP16 宽体数字隔离器 型号规格: CA-IS3080W, 加强绝缘, 内部穿透距离(绝缘厚度) > 0.4mm, 外部爬电距离规格 > 8.0mm, 通过 125°C的热循环试验(仅适用于海拔 5000米及以下) 样品数量: / 收样日期: / 样品来源: / 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 上海川土微电子有限公司 委托人地址: 上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 生产者: 上海川土微电子有限公司 生产者地址: 上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 生产企业: 宏茂微电子(上海)有限公司 生产企业地址: 上海市青浦工业园区C块, 崧泽大 道9688号</p>
<p>试验依据标准: GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见样品描述及说明。</p>	
<p>主检: 曾斌 签名:  日期: 2023.09.21</p>	
<p>审核: 韦雄纤 签名:  日期: 2023.09.21</p>	
<p>签发: 胥凌 签名:  日期: 2023.09.21</p>	
<p>备注</p>	<p>1. 试验依据实施规则: CQC11-471543-2022 信息技术设备、音视频设备和通信技术设备用光电耦合器安全 认证规则; 2. 本次申请为 OEM 派生申请。</p>

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	15801-DK001041-202309060
首页	√	1	15801-DK001041-202309060
报告组成	√	1	15801-DK001041-202309060
附页	/	/	/
变更确认表	/	/	/
产品描述报告	√	4	15801-DK001041-202309060
封底	√	1	/
安全测试报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

样品描述及说明

适用环境: [] ≤海拔 2000 米 [✓] ≤海拔 5000 米
 [✓]热带气候条件下 []非热带气候条件下

过电压等级 (OVC): []OVCI [✓]OVCI I []OVCI I I []OVCI I I I

污染等级 (PD): []PD1 [✓]PD2 []PD3

初级--次级之间的绝缘类型: []功能绝缘 []基本绝缘 []附加绝缘 [✓]加强绝缘

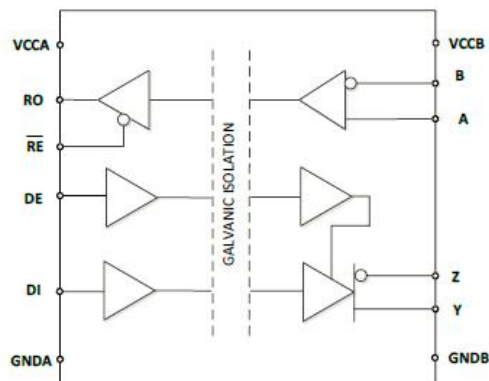
其他重要描述

- 本次申请的 SOP16 宽体数字隔离器型号为: CA-IS3080W、CA-IS3082W、CA-IS3086W、CA-IS3088W, 封装形式为 SOIC16-WB(W), 不同型号的产品之间差异仅在于型号命名不同, 其隔离通道结构、封装形式、所用材料、工艺流程等完全相同; 加强绝缘, 内部穿透距离 (绝缘厚度) > 0.4mm, 外部爬电距离规格 > 8.0mm, 通过 125°C 的热循环试验 (仅适用于海拔 5000 米及以下)。
- 产品丝印 (举例):

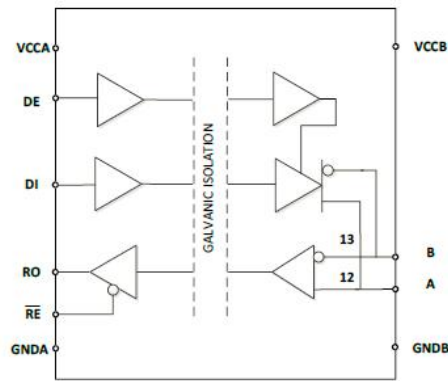


- 本次申请产品通过了最高试验温度为 125°C 的热循环试验。
- 功能框图:

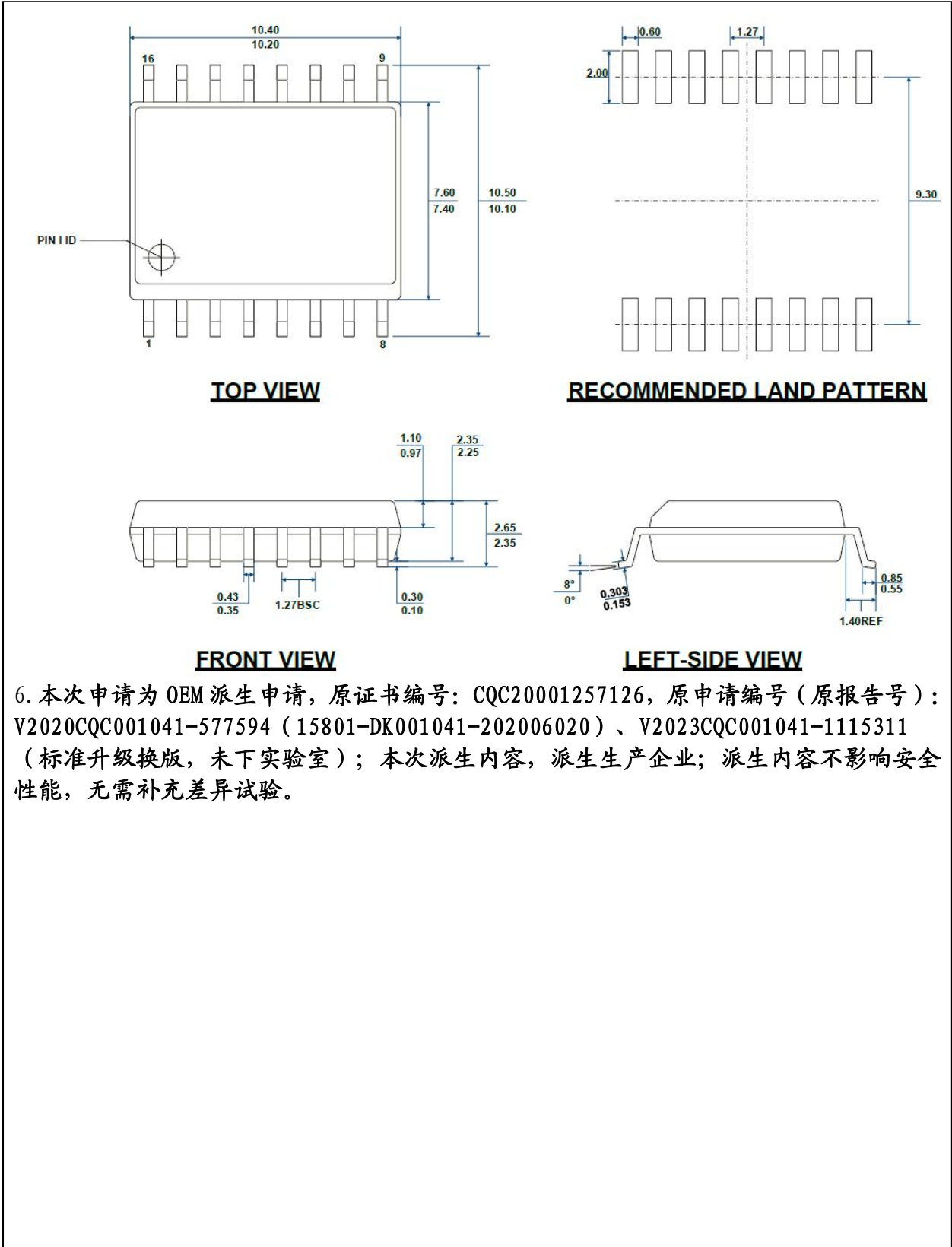
CA-IS3080, CA-IS3086 功能框图



CA-IS3082, CA-IS3088 功能框图



- 产品尺寸图: (单位为: mm)

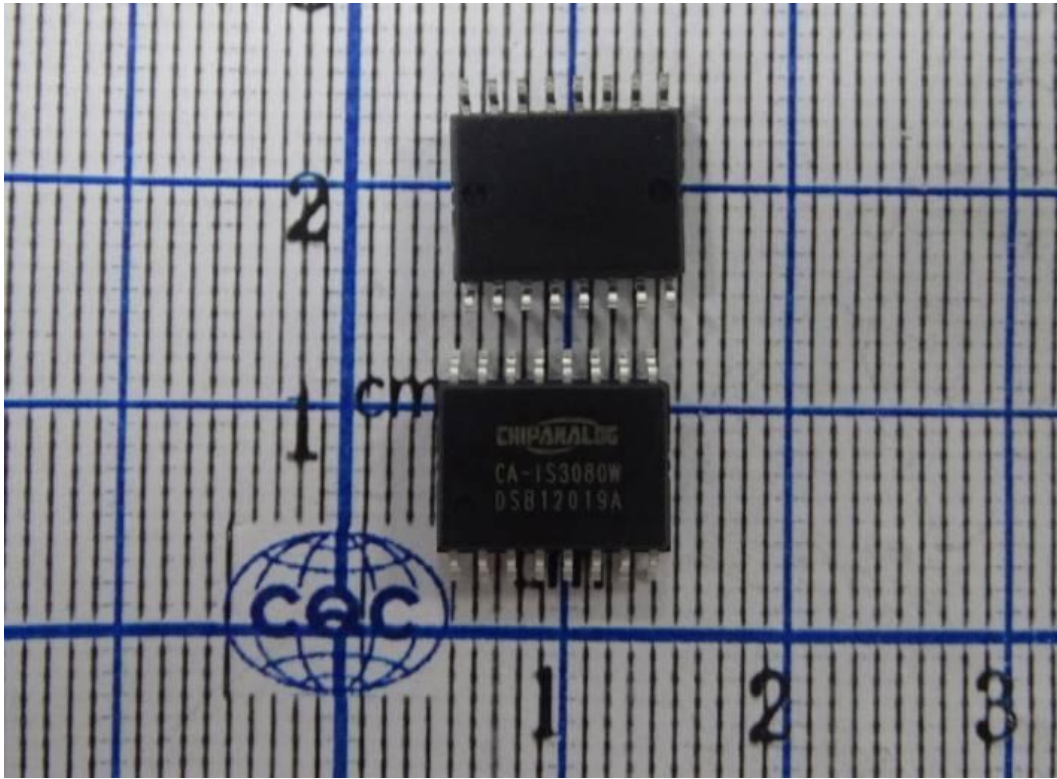


6. 本次申请为 OEM 派生申请, 原证书编号: CQC20001257126, 原申请编号 (原报告号): V2020CQC001041-577594 (15801-DK001041-202006020)、V2023CQC001041-1115311 (标准升级换代, 未下实验室); 本次派生内容, 派生生产企业; 派生内容不影响安全性能, 无需补充差异试验。

附表 1. 安全件清单

序号	位号	部件号	名称	型号	规格/材料	制造商 or 生产厂	认证标准	备注
1	/	/	线架 Lead Frame	16SOP-W(100*182) 4*12 ELF CU		ASM 先进半导体材料公司	GB4943.1-2022	--
2	/	/	银胶 Adhesive (Ag resin)	EN4900GC	/	日立 (Hitachi)	GB4943.1-2022	--
3	/	/	金线 (焊线) Gold Wire	0.8mil Au 线		贺利氏 (Heraeus)	GB4943.1-2022	--
4	/	/	晶片 Wafer	/	8 寸	东部高科 (DBH)	GB4943.1-2022	--
5	/	/	封装材料 (环氧树脂)	CEL9240HF	V-0	日立 (Hitachi)	GB4943.1-2022	--

样品照片



外观

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中国质量认证中心华南实验室

地 址：广东省广州科学城科珠路玉树工业园

邮政编码：510000

电 话：020-82966619

传 真：020-85190132

E-MAIL: cqcsc1@cqc.com.cn